ACCRETECH

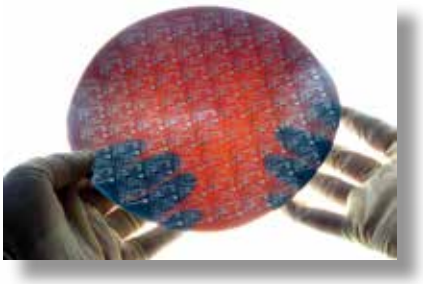
Polish Grinder

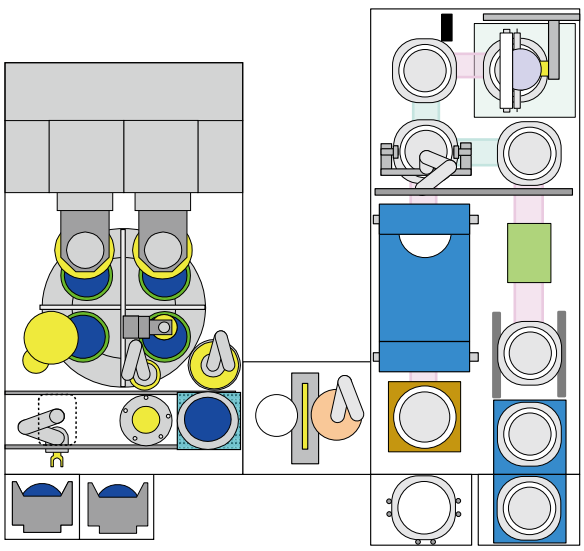
PG300ORM II

株式会社東京精密

Polish grinders

極薄ウェーハの量産加工を可能とした
システム・インテクレーション、
ポリッシュグラインダ PG3000RMⅡ





薄片化
研削からポリッシュによるストレスリリーフまで一貫した加工と、様々なアプリケーションにより超薄加工を実現。安定搬送システムと薄化に特化したDCテープ貼付＋保護テープ剥離機構のインテグレーションで安定した薄化生産に寄与します。

仕上げの多様化
ウェットポリッシュによるストレスリリーフのみならず、ゲッタリングを付与する EGF などのアプリケーションを提供できます。

拡張性
ML ダイシングとのシステムインテグレーションなど、より高品質なアプリケーションを提供できます。

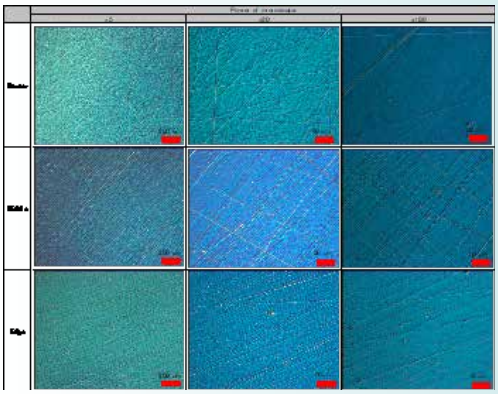
Various option

■ NCIG (Non Contact Inprocess Gauge)

自動TTV機能搭載

非接触タイプのウェーハ厚さゲージを搭載する事が可能です。

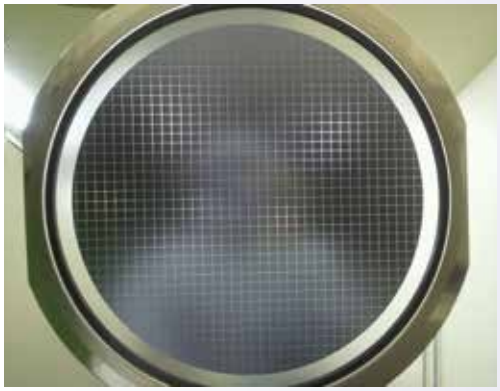
直接シリコンウェーハの厚さのみを計測してインプロセスで厚さ制御する事ができるので、表面保護テープの厚さバラツキや、WSSなどの基盤及び接着層の厚さバラツキの影響を受けずに、仕上げ厚さの精度向上が達成できます。
また、削った後のウェーハ形状を測定する自動TTV補正機能を搭載することで安定したウェーハを提供いたします。



■ EGF (Extrinsic Gettering Function)

ウェーハ裏面に金属イオンを捕捉する微小な欠陥を付与する事が可能です。

ウェーハの厚さが薄くなるとシリコンウェーハ内部にあるIG層(Intrinsic Gettering)が除去されてしまう為、金属イオンを捕捉する欠陥層が不足します。チップの抗折強度を維持しながらウェーハ裏面に微小欠陥を付与する事でEG層を形成する事ができます。



■ ML DICING Inline System (Integration System)

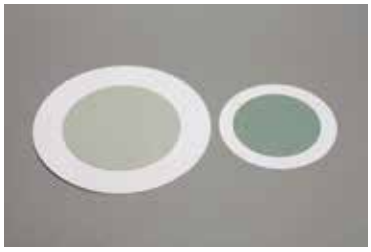
ML DICINGとのインテグレーションシステムを提供できます。特にウェーハが薄くなると、従来のブレードダイシングによる品質の維持が困難な傾向にありますが、当社独自のML DICINGを用いる事によりウェーハが薄くなっても高品質なダイシング品質が得られます。システムはインテグレーションされ、自動化され、薄いウェーハでも信頼性の高いハンドリングを可能にしています。

ACCRETECH CONSUMABLE

■ Grinding Wheel

TD2000K2-3W-5X-300

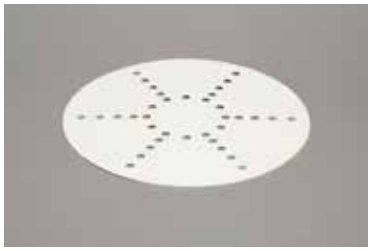
- TD: Tokyo Seimitsu Diamond Wheel
- 2000: Mesh Size
- K2: Resin Bond
  - K1:Hard Type
  - K2:Standard
  - K4:Soft Type
- 3W: Segment Width 3mm
- 5X: Segment Height 5mm



■ Dressing Disk

***TB325**

***TB2000**



■ Polishing Pad

***TP200V4 (ForPG200)**

***TP300V4 (For PG300/PG3000)**

■ Polishing Slurry

***TS200L (Standard)**

***TS200H (Low contamination)**

***TS200S (High throughput)**

株式会社東京精密

（本社）〒192-8515 東京都八王子市石川町 2968-2
TEL：(042)642-1701 FAX：(042)642-1798
https://www.accretech.com

お問い合わせ先

●仕様などの記載事項は製品改良のためお断りなしに変更することがあります。

C-63-824-J-2401